



Halbleiterfertigung bei Bosch

07. Oktober 2019

PI 11030 AE Fi/af

- ▶ **Aktuelles Portfolio**
Elektronische Bauelemente für Fahrzeuge sowie die Konsumenten- und Unterhaltungselektronik. Dazu gehören Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) wie Beschleunigungs-, Drehraten-, Druck-, Massenfluss-, Umwelt- und Magnetfeldsensoren sowie μ Projektoren, Anwendungsspezifische Schaltungen (ASICs) und Leistungshalbleiter.
- ▶ **Fertigungsstandorte**
Reutlingen (150-mm- und 200-mm-Technologie)
Dresden (300-mm-Technologie) ab 2022
- ▶ **Patente**
Bosch hält mehr als 1 500 Patente und Patentanmeldungen im Bereich der Halbleitertechnologie, 1 000 davon für die MEMS-Technologie.
- ▶ **Markt**
Bosch fertigt Halbleiter und MEMS-Sensoren für den Eigenbedarf. Große Teile des Portfolios werden auch am freien Markt angeboten.
- ▶ **Historie**
Seit nahezu 50 Jahren entwickelt und fertigt Bosch mikroelektronische Bauteile und Systeme; Bosch hat vor fast 25 Jahren den Halbleiter-Fertigungsprozess für mikroelektromechanische Sensoren (MEMS-Sensoren) entwickelt und ist dort Weltmarktführer.